

微电子器件基础

作者: Pannenets.F

时间: September 28, 2020

分类: 笔记

特别声明

北航微电子学院在 2020 年秋季学期开设的微电子器件基础课程, 课程教师为曾琅老师。

Pannenets F September 28, 2020

目录

1	绪论		1
	1.1	半导体物理回顾	1
		1.1.1 能带结构	2
		1.1.2 非平衡态	2
2	PN §		4
	2.1	PN 结的形成	4
	2.2	平衡态能带图	5
	2.3	耗尽近似: 泊松方程解析解	6
	2.4	耗尽区的长度	6
	2.5	外加电压	7
3	PN §		11
	3.1	正向导通电导 1	11
	3.2	结电容 1	11
	3.3	多数载流子	12
	3.4	内建电势	12
	3.5	少数载流子	12
	3.6	数字电路中的应用	12

第一章 绪论

微电子硅基芯片的尺度即将到达瓶颈,是否可能存在进一步改进的可能,是否可以 找到全新的替代材料?

1.1 半导体物理回顾

晶体结构部分

- 了解并使用密勒指数
- 理解基本的晶体结构
- 理解量子力学的基本知识

经典的理论只能处理单电子的问题,甚至 He_2 已经无法处理,而实际的固体存在 $10^{-23} cm^{-3}$ 的电子密度。进一步发现了晶体的周期性,三维重复性对问题进行了简化。对 硅片来说,晶圆的方向就是 [100] 晶向。当晶体纯度足够高时,我们就可以在单个的原胞 内部处理。

当硅原子相隔较远,电子不发生交叠,均处在 E_1 能级,若是逐渐接近,能量会变化为 $E\pm\Delta E'$ 的能带分布。若是有 N 个电子,不考虑自旋兼并度就有 N 个能带,考虑则是 2N 个。

假设我们有一块 N 原子晶体,那么能量以及相互作用的矩阵可以表示为

$$\begin{bmatrix} E_1 & E_{12} & E_{13} \\ E_{21} & E_2 & E_{23} \\ E_{31} & E_{32} & E_3 \\ & & \ddots \end{bmatrix}$$

但是特征值的求解几乎是不可能的,那么我们使用原胞的思想就可以块对角化,求解特征值对应的能量:

$$\begin{bmatrix} [4 \times 4] \\ & [4 \times 4] \\ & [4 \times 4] \\ & & \ddots \end{bmatrix}$$

实际上动量以及角动量对应着平移不变性以及旋转不变性。得到的E-K关系就是能量-动量关系。

关键方程

- 物理常数
- 密勒指数
- 晶面角度
- 立方晶面距离

1.1.1 能带结构

- 理解 E K 关系,从中提取速度、有效质量、等能面等信息,进一步获得电流等 关键量
- 理解态密度,费米积分,并进行简单计算
- 一定温度以及掺杂下, 计算电子空穴浓度

布洛赫波函数为 $\varphi = \phi(\mathbf{r})e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}}$ 。实际中电子以波包的形式传播, 其速度为群速度, 与 E - K 关系斜率相关(色散关系的倒数)。

综上,我们从真空电子**概率波**与晶格作用(周期势阱)得到了E-K关系,导出了有效质量以及群速度等关系,转换为另一个**粒子**的状态,简化问题。

若是需要求解电流密度 $J=i\cdot n\cdot v$, 其中 n 总满足式 1.1 , 为所有量子态的占据几率,其中 N(E) 为态密度。

$$n = \sum_{k=0}^{n=N} f(E(\mathbf{k})) = A \int_{\mathbf{k}} f(E(\mathbf{k})) d\mathbf{k}^3 A' \int_{E=0}^{\infty} f(E) N(E) dE$$
 (1.1)

最终得到

$$n = N_C e^{\frac{E_F - E_C}{kT}}$$
$$p = N_C e^{\frac{E_V - E_F}{kT}}$$

那么 $n \cdot p = N_C N_V e^{-\frac{E_g}{kT}} = n_i^2$ 其中 $E_g = E_C - E_V$ 。 无掺杂时, $n = p = n_i \approx 10^{10} \text{cm}^{-3}$ 近似绝缘。有掺杂时,电中性条件为

$$p - n + N_D - N_A = 0 (1.2)$$

在导带或者价带能量与费米能级相差 $3k_BT$ 及以上时,费米-狄拉克分布可以弱化为玻尔兹曼分布,并且可以称为简并半导体。

关键方程

- 不同维度的能量、动量态密度,
- 费米狄拉克分布
- 费米积分

1.1.2 非平衡态

• 理解载流子的产生与复合

- 理解载流子的扩散与漂移
- 初步求解简单的少数载流子扩散方程

虽然不满足 $np = n_i^2$ 但是仍均匀分布在空间中。当出现扰动时,偏离稳定,通过耗散能量逐渐回到平衡态。由于电子空穴成对出现,那么在恢复稳态时有

$$(n \pm \Delta n) \times (p \pm \Delta p) = n_i^2$$
, where $\Delta n = \Delta p$

复合中心辅助的产生与复合(SRH)

$$-\frac{\partial n}{\partial t}_{SRH} = -\frac{\partial p}{\partial t}_{SRH} = R_{SRH} = \frac{np - n_i^2}{\tau_p(n+n_1) + \tau_n(p+p_1)}$$
(1.3)

 D_P, D_N 分别是空穴、电子的扩散系数,单位是 cm²/sec

$$J_P|_{\text{diff}} = -qD_P\nabla p$$

$$J_{N|\text{ diff}} = qD_N \nabla n$$

考虑浓度差

$$J_N = qn\mu_N E + qD_N \nabla n$$

$$J_P = qp\mu_P E - (qD_P \nabla p)$$

第一项是漂移电流,第二项是扩散电流。

漂移电流的定义

$$J_n = qnv_{drift} = qn\mu_n \mathcal{E} = n\mu_n \frac{\mathrm{d}F_n}{\mathrm{d}x}$$

$$J_p = qpv_{drift} = qp\mu_p \mathscr{E} = p\mu_p \frac{\mathrm{d}F_p}{\mathrm{d}x}$$

其中 μ_n 是迁移率。

关键方程

- 半导体方程: 连续性方程与泊松方程
- 少数载流子扩散方程

第二章 PN结



PN结是其他微电子器件的基础。

PN 结的常见应用有:太阳能电池, GaAs / GaN 激光器,有机发光二极管,雪崩光电二极管, CMOS 图像传感器。OLED 是有机半导体的显示材料,怕水,寿命有限。

2.1 PN 结的形成

PN 结最早是通过热扩散,目前有沉积、扩散、激光掺杂等工艺。

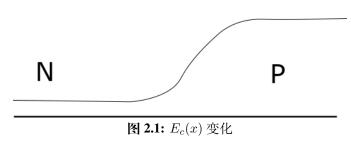
一般掺杂得到的是二维的器件,电流方向不是直线,难以求解。若是得到的是一个 很窄的器件,可以简化为一个一维问题,对第二个维度的依赖性会变低,只需考虑第一 维度的运动情况。

两种半导体直接相连是不能得到 PN 结的,因为断面上的原子不能形成化学键。对 N 型半导体,费米能级靠近导带,对于 P 型半导体,靠近价带。在两个体区中,N 型中 很多的施主杂质电离的正离子(无法移动),但是有等量的电子(可以移动, $n=N_D$);类似的 P 型存在可以移动的空穴($p=N_A$)。浓度差造成了扩散,那么 N 型靠近结区的 部分电子被中和,整体带正电,P 型对应部分带负电,这就是耗尽区。由于扩散的存在,出现 $n\cdot p>n_i^2$ 的瞬态。

电流分为两部分,漂移电流以及扩散电流。之前考虑的是扩散电流,因为此时还没有出现两部分的电势差。由于扩散后出现了静电荷,形成了电场,开始考虑漂移电流。电场逐渐增大,受到的阻力也越来越大,直到扩散电流与漂移电流相互抵消,进入稳态,即完成形成过程。

可以分为两个体区以及耗尽区(空间电荷区),耗尽区中没有自由移动的电荷,N型一侧有 $n \ll n_0$,另一侧有 $p \ll p_0$ 。

 $E_c(x)$ 如图 2.1

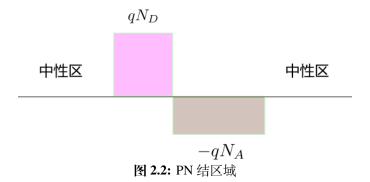


n(x) 满足

$$n(x) = N_c \exp(-\frac{E_c(x) - E_F}{kT})$$

其中, $E_c - E_F \approx 0.06 eV$, $kT \approx 26 meV$ 。

依靠本式,得到,空间电荷区几乎没有自由电荷。最后的分布如图 2.2

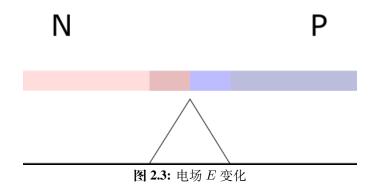


形成的电场为均匀变化,最大值为

$$E_{max} = \frac{q}{K_s \epsilon_0} x_p N_A = \frac{q}{K_s \epsilon_0} x_n N_D$$

可以得到对应的电势以及能带图。

2.2 平衡态能带图



分析空间电荷区电势在施主区的能级:

$$N_D = n = N_C \exp(\frac{E_i - E_C}{kT})$$

解得

$$\log(\frac{n}{N_C}) = -\frac{E_C - E_i}{kT}$$

那么

$$E_C = -kT\log(\frac{n}{N_C}) + E_i$$

同理

$$N_A = p = N_V \exp(-\frac{E_i - E_V}{kT})$$

$$E_V = E_i + kT \log(\frac{p}{N_V})$$

带隙为

$$E_g = E_C - E_V = -kT \log(\frac{n_i^2}{N_C N_V})$$

而

$$np = N_C N_V \exp(-\frac{E_g}{kT})$$

$$E_g = -kT\log(\frac{np}{N_C N_V})$$

内建电势满足

$$V_{bi} = E_q - (E_F - E_V) - (E_{C,otherside} - E_F)$$

$$V_{bi} == V_g + kT \log(\frac{N_C}{N_D}) + kT \log(\frac{N_V}{N_A}) = \frac{kT}{q} \log(\frac{N_A N_D}{n_i^2})$$

2.3 耗尽近似: 泊松方程解析解

泊松方程是静电变量的出发点,适用于三维的公式为

$$\nabla \cdot E = \frac{\rho}{K_S \epsilon_0}$$

杂质分布为,其中 $\rho = q(p-n+N_D-N_A)$

$$\frac{\mathrm{d}E}{\mathrm{d}x} = -\frac{\rho}{\epsilon_r} = \frac{\rho}{K_s \epsilon_0}$$

那么

$$E(x) = \int -\frac{qN_D}{\epsilon_r} dx$$
$$= -\frac{qN_D}{\epsilon_r} x$$

多次掺杂需要浓度的提升。

2.4 耗尽区的长度

在突变近似以及耗尽近似下,

$$\frac{\mathrm{d}E}{\mathrm{d}x} = \begin{cases} -qN_A/K_S\epsilon_0, & -x_p \le x \le 0\\ qN_D/K_S\epsilon_0, & 0 \le x \le x_n\\ 0, & else \end{cases}$$

得到

$$E(x) = \begin{cases} -\frac{qN_A}{K_S \epsilon_0} (x_p + x), & -x_p \le x \le 0\\ -\frac{qN_D}{K_S \epsilon_0} (x_n - x), & 0 \le x \le x_n \end{cases}$$

为了满足x=0的电场连续性,得到

$$N_A x_p = N_D x_n$$

求解电势, 电势满足 E = -dV/dx

设置 p 型区边缘的电势为参考电势 0 ,那么在 n 型区边缘的电势为 V_{bi} ,那么交界处的电势一致:

$$V_{bi} - \frac{qN_D}{2K_S\epsilon_0}x_n^2 = \frac{qN_A}{2K_S\epsilon_0}x_p^2$$

得到

$$x_p = \left[\frac{2K_S \epsilon_0}{1} \left(\frac{N_D}{N_A (N_A + N_D)} \right) \right]$$

$$x_p = \left[\frac{2K_S \epsilon_0}{1} \left(\frac{N_A}{N_D (N_A + N_D)} \right) \right]$$

$$W = x_n + x_p = \left[\frac{2K_S \epsilon_0}{1} \left(\frac{N_A + N_D}{N_A N_D} \right) \right]^{1/2}$$

2.5 外加电压

正向偏置是指的增加正向电压,使得正电压一端中性区费米能级下降,引起导带价带下降,这样也引起了 *Vbi* 的下降(平移)。费米能级下降的幅度为外加电压的大小。

$$V'_{bi} = V_{bi} - V_A$$

对原有的耗尽宽度的改进可以直接将 V_{bi} 替换为 V'_{bi} 。

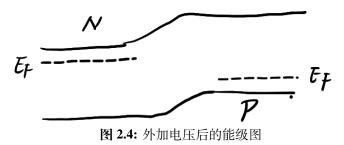
若是反向,在 \mathbf{n} 型区使得费米能级降低,内建电势 V_{bi} 会上升,其峰值电场强度会明显增强。

反向偏置的 PN 结可以作为电容。

PN 结的连续性方程:

$$\nabla \cdot E = q \left(p - n + N_D^+ - N_A^- \right)$$
$$\frac{\partial n}{\partial t} = \frac{1}{q} \nabla \bullet \mathbf{J}_N - r_N + g_N$$
$$\mathbf{J}_N = q n \mu_N E + q D_N \nabla n$$
$$\frac{\partial p}{\partial t} = \frac{1}{q} \nabla \cdot \mathbf{J}_p - r_P + g_P$$
$$\mathbf{J}_P = q p \mu_P E - q D_P \nabla p$$

添加外场后(正向),如 **图** 2.4。由于结区较短,产生复合未达到平衡,因此不满足 $np = n_i^2$,但是电子 / 空穴内部达到平衡,因此产生一种**准费米能级**,分别描述两种粒子的状态。 1 平衡时,电子空穴的准费米能级是重合的。**图** 2.5。



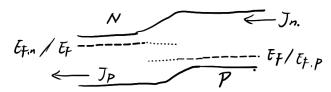


图 2.5: 外加电压后的准费米能级图

假设外加直流电压,在中性区中没有产生与复合,且 n 为常数,因此 $\nabla \cdot \mathbf{J} = 0$ 。 对于 \mathbf{N} 区空穴来说,浓度极低,只需考虑 $J_P = -qD_p\nabla p$,需要注意 p 的梯度,也就是只有扩散电流。而电流处处相等,另一区的总电流总是和这一侧的扩散相等的。

那么总电流

$$I = J_{P(N)} + J_{N(N)} = J_{P(n),D} + J_{N(n),D,D} = J_{P(n),D} + J_{N(p),D}$$

假设电流是常数,那么 $\nabla \cdot J = 0$:

又

$$J_N = qD_N \nabla \cdot n$$
, where $n = n_0 + \Delta n$

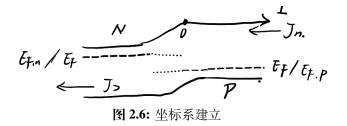
$$\nabla^2 \cdot \Delta n = 0$$

 $^{^{1}}$ 子系统平衡时间为 ps ,整体平衡为 μ s - ms 的量级

因此

$$\Delta n = A \cdot x + B$$

由边界条件,坐标系如图 2.6



$$\Delta n = A(x - L)$$

$$n(0) = N_C \exp(-\frac{E_C(0) - E_F}{kT})$$
, where $E_C(0) = E_C + V_{bi} - V_A$

那么

$$n(0) = N_C \exp(-\frac{E_C - E_F}{kT}) \exp(-\frac{V_{bi}}{kT}) \exp(\frac{V_A}{kT}) = \frac{n_i^2}{p} \exp(\frac{V_A}{kT}) = n_{0,p} \exp(\frac{V_A}{kT})$$
 那么

$$\Delta n = n_{0,p}(\exp(\frac{V_A}{kT}) - 1)$$

假设存在一个线性的变化,到电极处 $\Delta n = 0$ 存在一个线性的改变。

在无偏置时,扩散电子以及漂移电子可以动态平衡。正向偏置后漂移电子增多,扩 散电子减少。

根据结区的电子浓度以及平衡区的电子浓度计算分布,并进行线性近似正向偏置有

$$\ln J_T \approx qV_A/k_BT + \ln const$$

$$J_T = -q \left[\frac{D_n}{W_p} \frac{n_i^2}{n_A} + \frac{D_p}{W_n} \frac{n_i^2}{N_D} \right] (e^{qV_A\beta} - 1)$$

反向偏置有

$$J_T \approx const$$

反向偏置时:

$$n' = N_C \exp(-\frac{E_C - E_F}{kT}) = N_C \exp(-\frac{E_O + V_{bi} - V_A - E_F}{kT})$$

结区有

$$\frac{N_D N_A}{n_i^2} = \exp(\frac{V_{bi}}{kT}) \frac{n_i^2}{N_A}$$

那么

$$n' = \frac{n_i^2}{N_A} \exp(\frac{V_A}{kT})$$

V_{bi} 推导

由于

$$n = N_C \exp(-\frac{E_C - E_F}{kT})$$

对于 E_C 最低处为 n_1 另一侧为 n_2 ,那么

$$n_1 = N_D$$

$$n_2 = \frac{n_i^2}{N_A}$$

$$\frac{n_1}{n_2} = \exp(\frac{E_{C,2} - E_{C,1}}{kT})$$

$$\log(N_A N_D / n_i^2) = \frac{V_{bo}}{kT}$$

第三章 PN 结交流特性

电容的本质是电荷随电压变化。PN 结也是电容,并且是一个可变电容。对 PN 结来说结电容占主导,扩散电容较少。

3.1 正向导通电导

$$I = I_0(\exp(q(V_A - R_S I)\beta/m) - 1)$$

其中 m 是非理想因子。

$$\ln \frac{I + I_0}{I_0} = q(V_A - R_S I) \frac{\beta}{m}$$

$$\frac{1}{R} = \frac{\mathrm{d}I_A}{\mathrm{d}V_A}$$

3.2 结电容

结区宽度满足

$$W \propto \sqrt{V_{bi} - V_A}$$

那么随着小信号的增大,空间电荷区变窄,p 区费米能级下降;减小则空间电荷区变宽,p 区费米能级上升。

那么外加小信号 V_{AC} 后势垒也随之变化, 计算流程为

$$V_{AC} \rightarrow \Delta V_{bi} \rightarrow \Delta W \rightarrow \Delta Q = \Delta W_n N_D$$

$$C = \frac{\Delta Q}{V_{AC}}$$

若是看成平板电容器

$$C = \frac{\epsilon_r \epsilon_0 A}{(W_n + W_p)}$$

A 是结面积。由于宽度由直流偏置决定,因此这是一个可变电容。

3.3 多数载流子

运动速度为 ps 量级,决定结区的性质。

3.4 内建电势

$$\frac{1}{C_i^2} \approx \frac{2}{qN_D(x)K_s\epsilon_0 A^2} (V_{bi} - V_A)$$

3.5 少数载流子

少数载流子决定扩散电容。

$$J_N = qn\mu_N E + qD_N \frac{\mathrm{d}n}{\mathrm{d}x}$$

$$\frac{\partial n}{\partial t} = \frac{1}{q} \frac{\mathrm{d}J_n}{\mathrm{d}x} - r_N + g_N$$

$$\frac{\partial (n_0 + \Delta n_{dc} \Delta n_{ac} e^{j\omega t})}{\partial t} = D_N \frac{\mathrm{d}^2 (n_0 + \Delta n_{dc} \Delta n_{ac} e^{j\omega t})}{\mathrm{d}x^2} - \frac{\Delta n_{dc} + \Delta n_{ac} e^{j\omega t}}{\tau_n}$$

少数载流子的变化在微秒级。

3.6 数字电路中的应用

一般来说,在电压突变时,会发生电压保持、电流突变的行为来维持电容特性。